

Kupferbad SLOTOCOUP SF 20

Das Kupferbad SLOTOCOUP SF 20 wird bei der Produktion von HDI-Leiterplatten eingesetzt, um in einem Verfahrensschritt Blind Microvias vollständig zu füllen und gleichzeitig Durchgangsbohrungen zu verkufern, wobei auf der Oberfläche wenig Kupfer abgeschieden wird (kombiniertes Füllen von Blind Microvias mit minimalem Kupferschichtaufbau auf der Oberfläche).

Die aus dem Kupferbad SLOTOCOUP SF 20 abgeschiedenen Schichten sind hochglänzend mit einer hervorragenden Einebnung und exzellenter Metallverteilung. Dieser Elektrolyt wurde speziell für den Einsatz in vertikalen Durchlaufanlagen entwickelt.

Die Metallverteilung lässt sich durch Steuerung der Stromdichte und Elektrolytzusammensetzung an die geometrischen Bedingungen der zu beschichtenden Leiterplatten anpassen.

Der Ansatz von Kupferbad SLOTOCOUP SF 20 erfolgt mit drei Flüssigzusätzen.

Die Angaben in der Gebrauchsanleitung basieren auf unseren Labor- und Praxiserfahrungen. Da Ergänzungsmengen und Eingriffsgrenzen in Abhängigkeit von Materialart und -geometrie, deren Anwendung und der Anlagentechnik ggf. von den Angaben in der Gebrauchsanleitung abweichen können, sind diese Angaben nicht bindend.

Wichtiger Hinweis!

Wir bitten, diese Gebrauchsanweisung vor Einsatz des Verfahrens sorgfältig zu lesen und alle die Arbeitsweise beeinflussenden Parameter zu beachten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Im Interesse der eigenen Sicherheit beachten Sie bitte unbedingt die Gefahrenhinweise auf den Etiketten der Gebinde. Die Mindesthaltbarkeit der Produkte kann ebenfalls den Gebindeetiketten oder dem entsprechenden Qualitätszertifikat (QA03) entnommen werden.

Die aktuelle IMDS-Nummer für die aus dem Verfahren abgeschiedene Schicht kann im Internet unter www.schloetter.de/downloads eingesehen werden.

Für die Lagerung von chemischen Produkten ist die TRGS 510 maßgebend.

